

技術詞彙表

本詞彙表載有本文件所用有關我們及我們業務的若干技術詞彙的釋義。該等釋義未必與行業標準釋義一致，亦可能無法與其他公司採用的類似詞彙相比較。

「AI」	指	人工智能
「AMR」	指	自主移動機器人，是一種無需實時人手控制，即可在其環境中導航及執行任務的移動機器人，通常利用內置感應器、繪圖和路徑規劃軟件來實現安全移動並適應環境變化
「AOI」	指	自動光學檢測，一種利用相機及圖像處理算法，自動檢測印刷電路板或組件上缺陷(例如缺少元件、錯位和焊接缺陷)的在線或離線檢測流程
「老化測試」	指	一種可靠性篩選流程，將電子元件或系統在高應力(例如較高溫度或電壓)環境下運行一段較長時間，促使產品在出貨前提前暴露早期壽命失效
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「COC」	指	載板式晶片，半導體和光學封裝中的一種子組件，其中裸晶片安裝在載板基板上，以便於處理及連接
「芯片貼裝」	指	將半導體晶粒(晶片)物理安裝到封裝、基板或載體上的過程，是半導體和光模塊製造中的關鍵步驟
「DoF」或「自由度」	指	機器人通過關節實現的獨立運動方式數量，可實現獨特的旋轉運動(俯仰、偏航、滾轉)或平移運動(上下、左右、前後)
「具身AI」	指	人工智能的一個領域，專注於通過身體與物理環境之間的動態交互來學習和演化的智能體，該領域中的感知、行動及認知深度整合

技術詞彙表

「ERP」	指	企業資源規劃，一種用於管理及整合核心業務流程(如財務、供應鏈和營運)的軟件系統
「FA」或「光纖對準」	指	光纖陣列對準，光模塊製造中的高精度工序，將光纖與光子集成電路或其他光學元件對準，以確保高效的光傳輸
「FOUP」	指	前開式晶圓傳送盒，一種用於半導體晶圓廠的標準化密封載具，用來盛載及運輸多片晶圓；其從前側開啟以連接製程設備，同時維持受控且低污染的內部環境
「FPGA」	指	現場可程式閘陣列，一種集成電路，設計用於在製造後由客戶或設計師進行配置，常應用於高速處理任務
「智能具身產業機器人解決方案行業的全棧技術」	指	硬件技術(包括傳感器、驅動器、控制器及機械臂)和軟件技術(包括基於機器人操作系統構建的核心算法與系統，可實現機器人的感知、決策、執行及大規模調度)的結合
「人形機器人」	指	身體形態及自由度設計皆模仿人體結構(例如具備頭部、軀幹、手臂、腿部)的機器人，通常旨在在人類環境中操作並以更自然的方式與人互動
「IMU」	指	慣性測量單元，一種測量物體在三個軸向上的姿態角(或角速率)及加速度的裝置
「物聯網」	指	物聯網，連接設備的總體網絡以及促進設備與雲端之間以及設備之間通信的技術
「JOS」	指	本公司專有的機器人作業系統，整合感知、運動控制及規劃功能，以實現機器人的適應性表現

技術詞彙表

「主要客戶」	指	於2023年或2024年任一年度錄得年收入貢獻超過人民幣1.0百萬元的客戶
「主要客戶留存率」	指	於2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月期間，至少兩個報告期內對本公司貢獻收入的主要客戶(按綜合基準計算)的比例
「激光雷達」	指	光學雷達，一種遙感方法，利用脈衝雷射形式的光線測量距離並創建環境的3D表示
「MES」	指	製造執行系統，一種生產層級信息系統，可實時監控、追蹤及控制製造營運，管理企業規劃系統與生產現場設備之間的工單、物料、設備及品質數據
「MFU」	指	物料送料單元，一種用於在電子製造中將元件捲盤裝載並供應至表面貼裝技術(SMT)機器的移動小車或推車
「PCB」	指	印刷電路板，一種具有圖案化導電軌跡的層壓板，用於機械支撐及使電子元件電氣互連，為大多數電子設備構建基礎
「PCBA」	指	印刷電路板組裝，將電子元件焊接或組裝到印刷電路板(PCB)上的過程，或指已完成的電路板本身
「物理AI」	指	一個融合人工智能、機器人學與多學科工程的領域，強調算法與物理載體的協同設計，旨在創造能夠在真實世界中完成自主、自適應行動的智能物理系統

技術詞彙表

「PIC」	指	光子集成電路，一種將多個光子功能集成在單一晶片上的裝置，常用於光學通訊
「PV」或「光伏」	指	利用半導體材料展示光伏效應(一種在物理學、光化學和電化學領域中研究的現象)，將光能轉換為電能的過程
「光伏製造鏈供應商」	指	一種沿主流光伏製造鏈運營的公司，包括多晶硅、硅片、電池及組件，以及提供支持該製造鏈的專用材料及製造設備的公司，不包括逆變器及其他電力電子元件製造商
「研發」	指	研究及開發
「RMS」	指	機器人管理系統，本公司專有的軟件平台，旨在協調多機器人操作，包括實時任務生成、路線規劃及設備連接
「智能具身產業機器人」	指	一種應用於製造業環境的專用機器人系統，整合自主移動能力、具備類人靈巧度的作業單元及具身智能控制技術
「硅光技術」	指	一種以硅作為光學介質的技術，用於光信號的產生、處理、傳輸及偵測，常應用於高速數據通訊
「SLAM」	指	同步定位與地圖建構，一種計算技術，使機器人或裝置能夠在未知環境中建立地圖，同時估計其在地圖中的自身位置，通常使用激光雷達、相機或雷達等傳感器數據

技術詞彙表

「SLAM 機器人底盤」	指	一種移動式機器人底座(配備驅動、動力及控制功能的機械平台)，整合了SLAM算法及傳感器，使底盤能夠在其操作環境中自行定位及自主導航
「SMT」	指	表面貼裝技術，一種電子組裝方法，將表面貼裝封裝的元件直接放置在印刷電路板表面並焊接，可加大元件密度並實現智能化高速組裝
「晶圓」	指	一種薄片半導體，通常由硅製成，用於製造集成電路，並在光伏領域中用於製造太陽能電池
「WB」或「引線鍵合」	指	一種在裝置製造過程中，用於集成電路或其他半導體裝置與其封裝之間建立互連的方法
「WMS」	指	倉儲管理系統，一種軟件解決方案，可實現企業整體庫存透明化並管理供應鏈履行操作